



SSAC 2010

**SMD - Lötdraht für feinste Lötstellen mit
3 Metallen: Zinn - Silber - Kupfer**

**SMD Soldering wire for smallest soldering
joints with 3 metals: tin - silver - copper**

**bleifrei
mit 3 Metallen
leadfree
with 3 metals**



Die Miniaturisierung der Bauteile erschwert das Reparieren von Kleinbauteilen im Handlötbereich.

Auch kleine Lötdrahtdurchmesser, wie 0,5mm und 0,35mm sind häufig zu groß für Kleinstvolumenlötstellen. Diese Lötstellen sollen die gleiche Lebensdauer aufweisen, wie größere. Daher muß auf die Lötung, insbesondere im bleifreien Bereich eine größere Sorgfalt gelegt werden. EDSYN entwickelte aus dieser Notwendigkeit heraus einen feineren SMD-Lötdraht mit 5 Flußmittelseelen.

Der Durchmesser des SMD - Lötdrahts SSAC 2010 ist vergleichbar mit der Stärke eines zur Zeit im Umlauf gebrachten EURO - Geldscheine.

Repairs of smallest components will be more and more difficult because of the miniaturizing of the components small soldering wire diameters as 0,5mm and 0,35mm are often too large for such small volume solder joints. This kind of solder joints should have the same life time than bigger ones. Therefore you have to take more care for the hand soldering process especially with leadfree material.

EDSYN has developed a smaller SMD soldering wire with 5 flux cores.

The diameter of the SMD soldering wire SSAC 2010 has the same width as an actual used EURO bank note.



Technische Daten

- Legierung: Sn96,5 Ag Cu0,5
- Flußmittel nach: F - SW 32
- Spulengröße: 10 g
- Durchmesser: 0,2 mm
- Schmelzpunkt: + 217°C
(Solidus = Liquidus)



Technical data

- alloy: Sn96,5 Ag Cu0,5
- flux according to: F - SW 32
- spool size: 10 g
- diameter: 0,2 mm
- melting point: + 217°C
(Solidus = Liquidus)